

热点题材追踪

2026年6月25日 星期四 | 数据源: 东方财富 / 财联社 / 华泰MCP

⚠ 通联MCP行情数据盘后延迟同步中, 部分维度基于东方财富公开数据估算

市场一览

上证指数 **+0.24%** 深证成指 **+1.89%** 创业板指 **+2.84%**

黄白线分化, 权重强势、中小盘承压。成交额 3.59 万亿 (放量 3100 亿), 涨停 86 家, 连板 16 只, 封板率 73%。全市场超 4200 只个股下跌, 资金向半导体/元件/券商等权重板块集中。华泰资金面: 散户净流出 428 亿, ETF 净流出 552 亿。

🔗 存储芯片 ← 先进封装 ← PCB ← MLCC/被动元件

🔗 AI算力 ← CPO/光通信 ← 数据中心 (推理需求爆发)

📌 科技权重股 ↔ 中小盘题材股 (今日分化加剧)

83

热度评分

📁 存储芯片/MLCC/被动元件 — 今日最强主线, 美光财报超预期引爆, 元件行业主力净流入 114.86 亿居全市场第一。

MLCC +5.22% 存储 +3.78% 被动元件 +4.69% 涨停 7 家 **高潮期**

强 美光科技第三财季财报远超预期, 欧洲半导体设备三巨头涨 2.6%-3.4% 财联社

中 IDC: 全球 AI 产业进入超级周期, 从基建转向企业级应用爆发 财联社

中 HBM 高带宽内存概念 +3.93%, 存储芯片国产替代加速 东方财富

北京君正 300223 **龙头**

德明利 001309 **龙头**

风华高科 000636 **中军**

澜起科技 688008 **中军**

艾华集团 603989 **弹性**

● 北京君正、艾华集团等龙头近 20 日涨幅超 50%, 高位加速后回调风险极大, 追高需谨慎

76

热度评分

📁 PCB/先进封装 — 多只高位股续创新高, PCB 主力净流入 107.77 亿, 但连板积累的风险不可忽视。

PCB +1.88% 中芯概念 +3.02% 涨停 5 家 **高潮期**



强 美光财报超预期 → 半导体全产业链共振，先进封装直接受益于 HBM 扩产

财联社

中 IDC：2027 年推理占智能算力 70%+，边缘基建增速超核心 DC

财联社

长电科技 600584 **龙头**

中材科技 002080 **龙头**

东山精密 002384 **中军**

中京电子 002579 **补涨**

芯碁微装 688630 **产业链**

● 中材科技/贤丰控股 12 天 6 板，长电科技 4 天 3 板，多只龙头连板过高，一旦分歧可能出现踩踏

70

热度评分

💡 CPO/光通信 — 新易盛创历史新高，推理算力时代光通信需求确定性增强，但龙头已处高位。

光通信 +2.31% 通信技术流入 105.26 亿 **发酵期**

中 IDC：2027 年推理占智能算力 70%+，边缘基础设施增速超核心 DC

财联社

中 美光财报超预期，全球 AI 基建加速，数据中心光互联需求持续增长

财联社

新易盛 300502 **龙头**

中际旭创 300308 **中军**

天孚通信 300394 **中军**

罗博特科 300757 **补涨**

● 新易盛等龙头已处历史高位，通信行业整体景气度仅 41.88，细分龙头可能被行业均值拖累估值

62

热度评分

🏠 券商 — 成交额 3.59 万亿放量利好经纪业务，但 ETF 净流出 552 亿显示机构可能在减仓，持续性存疑。

证券 +3.05% 流入 43.92 亿 **启动期** **NEW** 新出

中 A 股成交额 3.59 万亿放量 3100 亿，券商经纪业务直接受益

财联社

中 美国大行通过压力测试提高股利，提振金融板块情绪

财联社

东方财富 300059 **龙头**

中信证券 600030 **中军**

新华保险 601336 **联动**

● 4200 只个股下跌背景下券商拉升可能是资金“避险抱团”，需观察后续 2-3 日成交额能否维持

58

热度评分



AI推理/应用 — IDC 重磅判断：AI 从基建转向应用爆发。趋势信号明确，但 A 股应用层标的分散，尚未形成板块合力，适合中长期布局。

科技风格 +3.44% AI芯片 +1.64% 游戏 +1.15% 启动期

强 IDC 全球高级副总裁：AI 产业进入超级周期，从基建转向企业级应用爆发 财联社

中 IDC 中国副总裁：2027 年推理算力 70%+，Token 成本是竞争关键 财联社

澜起科技 688008 中军 **海光信息 688041** 产业链 **巨人网络 002558** 弹性

● AI 应用层在 A 股缺乏明确的板块指数和龙头企业，短期缺乏业绩验证，适合中长期布局

题材演化追踪

上次追踪：2026-06-23 (间隔 2 个交易日)

| 题材 | 06-23 | 06-25 | 变化 | 标记 |
|-----------|-------|-------|----|----|
| 存储芯片/被动元件 | 75 | 83 | +8 | 持续 |
| PCB/先进封装 | 72 | 76 | +4 | 持续 |
| CPO/光通信 | 65 | 70 | +5 | 持续 |
| 券商 | — | 62 | — | 新出 |
| AI推理/应用 | 52 | 58 | +6 | 持续 |

明日观察与催化剂快照

明日验证条件

- 1 半导体龙头是否继续放量站上 5 日均线？美光财报映射效应能否延续至第二日？
- 2 PCB 高位连板龙头是否出现分歧？龙头开板是否引发板块踩踏？
- 3 成交额能否维持 3 万亿以上？若缩量至 3 万亿以下，券商+科技权重可能承压
- 4 4200 只个股下跌后，中小盘能否修复？黄白线是否收敛？
- 5 量子科技人才特训班能否催生新题材？关注中科大系量子概念股异动

近期催化剂快照 (未来 1-2 周)

聚焦宏观/行业事件，不列个股 (除有产业逻辑的半导体龙头)

| 日期 | 类型 | 事件 | 级别 | 关联题材 | 逻辑 |
|----------|----|-------------|----|-----------|-------------------------------|
| 6/30 (一) | 宏观 | 中国6月PMI发布 | 中 | 全市场 | 制造业景气度领先指标，影响市场对半导体/元件行业周期的预期 |
| 7/8 (二) | 宏观 | 美联储FOMC纪要公布 | 中 | 半导体/券商 | 全球风险偏好，若偏鹰则压制科技股估值 |
| 7/9-10 | 宏观 | 中国CPI/PPI发布 | 中 | 全市场 | 通胀数据影响货币政策宽松空间 |
| 7/15 (二) | 业绩 | A股半年报预告截止日 | 高 | 存储/AI/光通信 | 业绩"排雷"，超预期个股受追捧，暴雷股面临抛压 |

7月下
旬

政
策

中央政治局会议 (预
计7月底)

● 高

全市场

定调下半年经济政策方向, A股核心主
线风向标

注: PMI/CPI/PPI 发布日期为惯例时间, 以实际公布为准; 政治局会议日期为市场预测, 以新华社公告为准。

⚠ 以上内容仅供研究参考, 不构成任何投资建议。市场有风险, 投资需谨慎。

数据来源: 东方财富 / 财联社 / 华泰MCP | hot-topics-tracker v2.5.0 | 2026-06-25 15:45 CST

